

**ТАБЛИЦА (2)**  
свойств и процесса обработки  
фотополимерного сухого пленочного фоторезиста Riston, фирмы DuPont

Серия	ES-100		FX 900		FX 250		LDI	
<b>Назначение</b>	<b>Etcmaster</b> Для кислого травления внутренних слоев многослойных печатных плат.		Для кислого и щелочного травления. Для жестко-гибких подложек <b>Покрытие</b> для Меди, Олова, сплава Олово/Свинец, Никеля и Золото		Для кислого и щелочного травления и процесса селективной металлизации. <b>Покрытие</b> для Меди, Олова, сплава Олово/Свинец, Никеля и Золото		Для прямого лазерного изображения, кислого травления. <b>Покрытие</b> для Меди, Олова, сплава Олово/Свинец, Никеля и Золото	
<b>Толщина</b>	ES-102	30 мкм	FX930 FX940	30 мкм 40 мкм	FX250	50 мкм	LDI7030 LDI7040 LDI7250	30 мкм 40 мкм 50 мкм
<b>Освещение</b>	желтый светофильтр марки EncapSulite Fuji Yellow No. FV 30							
<b>Подготовка поверхности перед ламинированием</b>								
<b>Ламинирование</b>								
Температура валиков	100 - 115°C		105 - 120°C		115 - 120°C		115 - 120 °C	
Скорость валиков	0,6 - 1,5 м/мин							
Давление воздуха	0 - 2,8 бар							
<b>Время выдержки-</b>	определяется временем остывания заготовки до комнатной температуры							
<b>Оптимальное-</b>	15 мин .Максимальное время хранения: при сухом ламинировании до 3 дней, влажном - 2 часа							
<b>Экспонирование</b>								
Энергия экспонирования мДж/см <sup>2</sup>	ES-102	20-60	FX930 FX940	40-115 45-125	FX250	40-150	LDI7030 LDI7040 LDI7250	13-28 13-28 20-40
Шкала SST (клин Штоуффера)	8-10		6 - 9		6 - 10		6 - 8	
Разрешение Зазор/проводник	75/75		15/15		50/50		40/40	
<b>Время выдержки</b>	Между экспонированием и проявлением от 10 мин до 3 дней							
<b>Проявление</b>								
Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	0,7 - 1,0 вес.% (рекомендовано 0,85 вес.%)							
Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> HO <sub>2</sub>	0,8 - 1,1 вес.% (рекомендовано 1,0 вес.%)							
K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	9-12г/л		0,7 - 0,8 вес.%		0,8 - 1,1 вес.% (рекомендовано 0,9 вес.%)			
Давление струи	1,4-2,1 бар		1,4-2,4 бар		1,5-1,8 бар		1,4-2,2 бар	
Температура	27 - 35°C		24-30 °C		27 - 35 °C		27-32 °C	
Точка остановки процесса проявления	50-65 % От длины камеры проявления				50-70 % От длины камеры		50-65 % От длины камеры	
<b>Время проявления</b>	ES-102	22-30	FX930 FX940	30сек 36 сек	FX250	45-52сек	LDI7030 LDI7040 LDI7250	25-35 сек 32-42 сек 45-50 сек
<b>Пеногаситель</b>	0,5 мл/л *(FoamFree940)							
<b>Время хранения</b>	после проявления до металлизации рекомендуется 0-5 дней							
<b>Предварительная очистка-</b>	рекомендуется кислая очистка и микротравление							
<b>Удаление фоторезиста</b>								
<b>Раствор</b>	1,5-1,7 - 3,0 % KOH / NaOH							
<b>Температура</b>	55 °C							
<b>Время снятия (3% NaOH)</b>	ES-102	68сек	FX930 FX940	30 сек 50сек	FX250	70 сек.	LDI7030 LDI7040 LDI7250	60-80 сек 90-120сек 50-70 сек
<b>Время снятия (3% KOH)</b>	73сек				FX250	70 сек.		

Специалисты компании «Лассо–центр» обеспечат Вас необходимой информацией, проконсультируют по всем техническим вопросам, помогут в выборе необходимого материала, окажут техническую помощь в освоении материала и оборудования у Вас на производстве.